

**2023中国西部半导体及集成电路产业博览会**

**暨“两链”融合创新发展论坛**

**主体内容**

**一、大会概况**

**名称：**2023中国西部半导体及集成电路产业博览会暨“两链”融合创新发展论坛（简称“ CWIC2023”）

**主题：**聚焦 创新 合作

**时间：**2023年5月25-27日

**地点：**西安国际会展中心（浐灞）

**组织机构：**

指导单位：中国半导体行业协会

陕西省工业和信息化厅

陕西省科学技术厅

主办单位：陕西省数字经济发展协会

西安浐灞生态管委会

协办单位：陕西省半导体行业协会

安徽省半导体行业协会

江苏省半导体行业协会

浙江省半导体行业协会

上海市集成电路行业协会

天津市集成电路行业协会

深圳市半导体行业协会

深圳市芯片行业协会

成都市集成电路行业协会

绍兴市集成电路行业协会

池州市半导体行业协会

杭州数字经济联合会

西安电子科技大学工程技术研究院有限公司

承办单位：中国西部半导体及集成电路产业博览会组委会

西安麦格斯会展服务有限公司

**二、大会内容**

本次大会历时3天，展览展示+高峰论坛+技术项目推介大赛颁奖等活动。

1. 展览展示

时间：2023年5月25-27日

地点：西安国际会展中心

1. 博览会开幕式暨“两链”融合创新发展论坛

地点：西安国际会展中心

参会人员：拟邀请国家部委司局领导、省区市厅局级领导、国内外院士、知名院校、科研院所、行业知名企业代表出席参会。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 活动内容 | 主持人 |
| 09:30-09:50 | 开幕式 | 陕西省工业和信息化厅副厅长 黄新波 |
| 09:30-09:35 | 主持人口播开场，介绍与会嘉宾  拟出席领导和嘉宾  邬贺铨 中国工程院院士  郝 跃 中国科学院院士  戴彬彬 陕西省副省长  叶牛平 市委副书记、代市长  新疆自治区领导（待定）  黑龙江省领导（待定）  陈 忠 陕西省工业和信息化厅厅长  王亦斌 江西省工业和信息化厅一级巡视员  黄新波 陕西省工业和信息化厅副厅长  杨旭东 中华人民共和国工业和信息化部电子信息司副司长  孟 浩 西安市人民政府副市长  张 立 中国半导体行业协会常务副理事长兼秘书长、中国电子信息产业发展研究院院长  田盘龙 陕西省电子信息集团原董事长 陕西省工业经济联合会会长  耿 莉 西安交通大学微电学院院长 教授  单光宝 西安电子科技大学华山特聘教授 军科委专家  臧 冲 盐城市工业和信息化局局长  马 哲 宝鸡市工业和信息化局副局长  其他外省市嘉宾，陕西省各地市领导待定 |  |
| 09:35-09:40 | 中华人民共和国工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东开幕式致辞 | 领导致辞 |
| 09:40-09:50 | 陕西省人民政府副省长戴彬彬开幕式致辞 |
|  | 主持人宣布大会开幕 | 黄新波 陕西省工业和信息化厅副厅长 |
|  | | |
| 09:50 | 参观巡馆 | 所有领导嘉宾及参加开幕式企业、协会代表、观众 |
| 时间 | 演讲主题 | 演讲嘉宾 |
| 10:10-10:25 | 中国半导体行业协会发布行业发展现状报告 | 张立 中国半导体行业协会常务副理事长兼秘书长、中国电子信息产业发展研究院院长 |
| 10:25-10:35 | 6G技术发展现状及未来芯片发展难点 | 邬贺铨 中国工程院院士 |
| 10:35-10:45 | 介绍陕西省半导体及集成电路产业链发展情况 | 田盘龙 陕西省电子信息集团原董事长 陕西省工业经济联合会会长 |
| 10:45-10:55 | 主题待定 | 郝跃 中国科学院院士 |
| 10:55-11:10 | 用“芯”助力 5G改变社会 | 任奇伟博士 紫光展锐CEO |
| 11:10-11:25 | 光电融合集成突破信息技术瓶颈 | 耿莉 西交大微电子学院院长、教授，微纳电子与系统集成研究所所长 |
| 11:25-11:40 | Chiplet三维异构集成技术发展 | 单光宝 西安电子科技大学华山特聘教授 军科委专家 |
|  | | |
| 14:00-14:15 | 题目：ChatPGT 带来的国内算力芯片封装新机遇 | 刘卫东 天水华天科技股份有限公司 |
| 14:15-14:45 | 1、铜川市光电子产业发展情况及招商推介  政府发布或解读最新产业链投资推介会（陆续征集中） | 铜川市政府  西安市政府或外地市 |
| 14:45-15:00 | 签约仪式：筹备阶段将征集校企合作、银企对接、产教融合、 产业链合作等合作项目组织签约。 | 西安交大，西安电子科技大学，企业 |
| 15:00-15:10 | 信芯杯设计大赛颁奖典礼（待定） | 青岛信芯科技，交通大学 |
| 15:10-16:30 | 全面注册制下企业IPO上市规划及股权融资专项解读会 | 中小企业合作发展促进中心 |
| 备注：以上具体时间节点根据现场实际时间略有调整 | | |
|  | | |
| 第二天活动  主题 | 热点技术专题论坛，聚焦集成电路及半导体领域研发与应用推广，以产业链生态体系、产教融合、技术交流等热点领域话题 | |
| 变革氮气供应模式，优化炉内气氛控制  时间：5月26日10：00-10:25  地点：西安国际会展中心6号馆 | 空气化工产品（西安）有限公司 |
| 突破半导体卡脖子技术——关键精密零部件（偏振玻璃）实现国产化。  时间：5月26日10：25-10:50  地点：西安国际会展中心6号馆 | 飞秒光电科技（西安）有限公司 |
| 主题待定  时间：5月26日10：50-11:15  地点：西安国际会展中心6号馆 | 陕西三海电子科技股份有限公司 |
| （第三天） | 博览会重点院校师生开放日，解决校企“人才链”互动对接问题，企业同步发布人才需求信息 | 交大、电子科技大学、西工大，长安大学等重点院校 |
| 后面同期活动会议信息持续更新中...... | | |

大会联系办公室：

西安市西安国际企业中心B座609

联系人：杨 栋 13072992486

电 话：029-86363366



中国西部半导体及集成电路产业博览会暨“两链”

融合创新发展论坛组委会

2023年5月10日